

SCREEN NOW

85号

株主通信

WINTER 2012

特集

2013年3月期 第2四半期決算報告

目次

株主の皆さまへ	01
連結決算ハイライト	03
主要事業別レポート	04
決算Q&A	06
(要約)連結財務諸表	07
クローズアップ —スマートフォンと当社製品—	09

Fit your needs, Fit your future

期待に応えて、未来を形に...



取締役社長 最高執行責任者(COO)
橋本 正博

取締役会長 最高経営責任者(CEO)
石田 明

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。このたびは通期での大幅な赤字予想および無配の予想を発表し、株主の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心よりおわび申し上げます。ここに2013年3月期第2四半期累計期間(2012年4月1日～2012年9月30日)の業績および今後の取り組みにつきまして、ご報告いたします。

※本誌に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、今後の世界経済やエレクトロニクス業界の技術変化、半導体・FPDパネルの市況などにより、実際の業績等と大きく異なる可能性があります。

2013年3月期第2四半期累計期間の業績

当上半期における当社グループを取り巻く事業環境は、半導体業界において、スマートフォンやタブレット型端末の需要増加を背景に一部の半導体メーカーによる設備投資は底堅く推移したものの、先行き不透明な経済状況やパソコン需要の低迷等により、多くの半導体メーカーは設備投資を抑制する動きを強めました。液晶パネル業界では、パネルメーカーの急激な業績悪化に伴い設備投資が大幅に減少しました。

このような事業環境の中、当社グループの業績は、売上高は958億円と前年同期に比べ271億円(22.1%)減少しました。利益面では、売上の大幅な減少により、営業損失は35億円(前年同期は90億円の営業利益)、経常損失は36億円(前年同期は88億円の経常利益)となりました。また、特別損失において保有株式の時価下落に伴い投資有価証券評価損11億円を計上したことなどに加え、経営環境の著しい変化により繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、回収が見込めない部分について単独の繰延税金資産を取り崩すこととし、法人税等調整額(税金費用)35億円を計上したため、四半期純損失は91億円(前年同期は65億円の四半期純利益)となりました。

通期業績の見通し

今後の経済環境は、欧州債務問題の長期化や米国の景気問題、中国をはじめとする新興国経済の減速などに加え、主要国におけるトップの選挙・交代が及ぼす景気への影響などにより、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。また、当社を取り巻く事業環境では、半導体業界におい

て、先行き不透明な経済環境や長期化するパソコン需要の低迷を背景に、半導体メーカーは設備投資をさらに抑制するものと想定しております。

このような環境のもと、当社グループの通期業績予想につきましては、主に半導体機器事業の売上・利益が前回予想を下回ると見込まれることから、2012年8月7日に公表した数値を下記のとおり下方修正いたしました。

また、期末配当につきましては、多額の損失を計上する見込みであることから、誠に遺憾ではございますが、無配とさせていただきます。

なお、今回の通期業績予想および配当予想の修正に対する経営責任を明確にするべく、取締役および執行役員の月額報酬を2012年11月より25～10%減額することにいたしました。

2013年3月期通期業績予想

(単位：億円未満切捨)

	2013年3月期 (前回発表予想)	2013年3月期 (今回修正予想)	2012年3月期 (実績)
売上高	2,130	1,900	2,500
営業損益	35	△70	134
経常損益	25	△75	122
当期純損益	5	△140	46

事業環境の変化への対応

前述いたしましたとおり、半導体メーカーおよび液晶パネルメーカーの設備投資が一層抑制されるなど、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化し、一段と厳しさが増しております。当社グループでは、この環境変化に対応するため、以下の対応策を講じてまいります。

○緊急対応策の強化

①変動費削減

海外調達の際のさらなる推進や設計の見直しにより、変動費の削減を図ります。

②固定費圧縮

選択と集中による研究開発の効率化、設備投資抑制による減価償却費の低減、経費削減などを進め、固定費の圧縮を行います。

○損益分岐点のさらなる引き下げ

来期以降を見据え、損益分岐点をさらに引き下げるべく、収益構造改善の早期実行を図ってまいります。

当社グループは、上記の対応策を速やかに実行していくとともに、半導体洗浄装置やPOD装置など、当社が高い競争力を有する製品の販売拡大を進めることにより、早期の収益改善と業績向上を図ってまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

取締役会長 最高経営責任者(CEO) 石田 明
取締役社長 最高執行責任者(COO) 橋本 正博

連結決算ハイライト

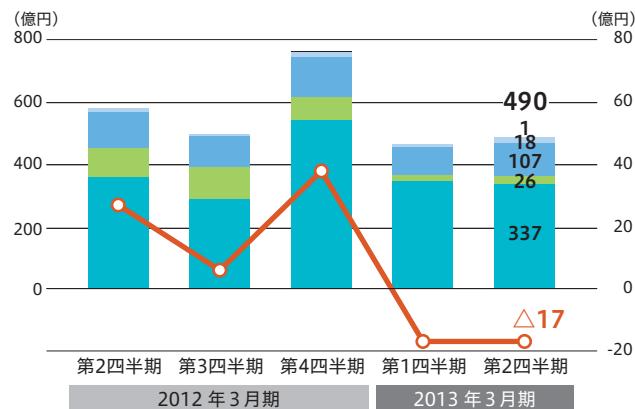
●2013年3月期連結経営成績

(単位: 億円未満切捨)

	第1四半期 2012年4月1日から 2012年6月30日まで	第2四半期 2012年7月1日から 2012年9月30日まで	前年同期 2011年7月1日から 2011年9月30日まで	第2四半期累計期間 2012年4月1日から 2012年9月30日まで	前年同期 2011年4月1日から 2011年9月30日まで
売上高	467	490	584	958	1,230
営業損益	△17	△17	27	△35	90
経常損益	△16	△20	27	△36	88
四半期純損益	△25	△66	18	△91	65

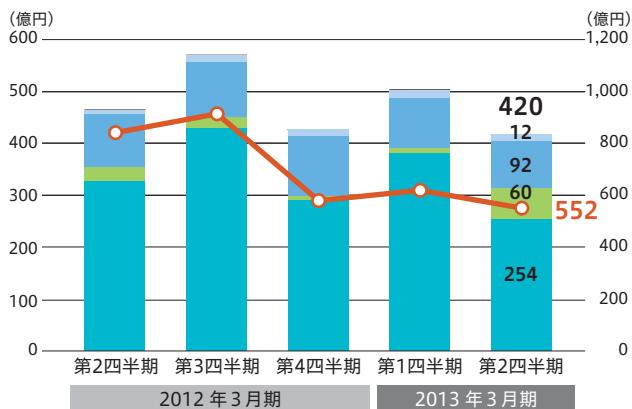
●売上高・営業損益

■ 半導体機器事業 ■ FPD機器事業 ■ メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業
 (■ 印刷関連機器 ■ プリント基板関連機器 ■ その他 ○ 営業損益[右目盛])



●受注高・受注残高

■ 半導体機器事業 ■ FPD機器事業 ■ メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業
 (■ 印刷関連機器 ■ プリント基板関連機器 ○ 受注残高[右目盛])



●2013年3月期連結業績予想

(単位: 億円)

	売上高	営業損失	経常損失	当期純損失
通期	1,900	△70	△75	△140

(注) 財務数値につきましては、金額は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入して表記しております。

●配当予想

2013年3月期の期末配当につきましては、多額の損失を計上する見込みであることから、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。

半導体機器事業

当期の業績(第2四半期累計期間)

●売上高 685億円(前年同期比 18.8%減)



半導体メーカーの設備投資が総じて低調に推移したことから、売上は前年同期に比べて大幅に減少しました。製品別では、半導体の微細化の進展により枚葉式洗浄装置の売上は増加しましたが、バッチ式洗浄装置が大幅に減少しました。

●営業損失 △27億円(前年同期は93億円の営業利益)

売上の大幅な減少に加え、製品構成の変化や工場操業度の低下による利益率の悪化により、営業損失を計上しました。

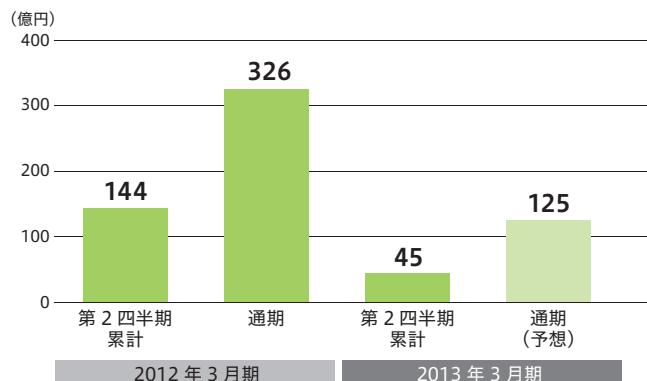
今後の見通しと取り組み

半導体メーカーの設備投資は、今後さらに抑制されると予想されます。このような状況下、コスト削減と品質向上に一層取り組んでいくとともに、先端分野での枚葉式洗浄装置の販売拡大を進め、収益の確保を図ってまいります。

FPD 機器事業

当期の業績(第2四半期累計期間)

●売上高 45億円(前年同期比 68.7%減)



テレビ需要の低迷による大型パネル用製造装置の売上減少に加え、高精細液晶パネル向けの中小型用製造装置についても伸び悩んだことから、前年同期に比べて大幅な減収となりました。

●営業損失 △6億円(前年同期は10億円の営業損失)

売上が大幅に減少したものの、エネルギー分野の開発部門を移管したことによる固定費減少などで、営業損失は前年同期に比べて縮小しました。

今後の見通しと取り組み

液晶パネルメーカーの設備投資が引き続き低調に推移すると予想されることから、海外調達の推進や設計変更により、変動費の低減に一層注力してまいります。また、有機EL用ノズルプリンティング装置の受注獲得を目指します。

メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業

当期の業績(第2四半期累計期間)

●売上高 225億円(前年同期比 5.7%減)



▶印刷関連機器：196億円

主に国内での買い替え需要に伴いCTP装置の売上は増加しましたが、POD装置が減少し、全体では前年同期に比べ減収となりました。

▶プリント基板関連機器：28億円

直接描画装置の新製品が堅調に推移したものの、外観検査装置が減少したため、売上は前年同期並みとなりました。

●営業利益 7億円(前年同期比 32.4%減)

第1四半期(4-6月)の営業損失を第2四半期(7-9月)でカバーし、上半期で営業黒字を確保しました。

今後の見通しと取り組み

印刷関連機器では、CTP装置は国内の買い替え需要を確実に捉えるとともに、新興国向けの新製品を投入してまい

ります。POD装置は、日本、欧州、米国のショールームを活用し、販売拡大を図ってまいります。

プリント基板関連機器では、国内外のサービス体制を強化し、直接描画装置の販売拡大に努めます。

また、海外調達の促進により、コスト削減と為替変動リスクの低減を図ってまいります。

用語解説

枚葉式洗浄装置：ウエハーを1枚ずつ処理する洗浄装置。

バッチ式洗浄装置：複数のウエハーを一括で処理する洗浄装置。

ノズルプリンティング：微小ノズルから材料を吐出して基板に均一に塗布する当社独自の手法。マスクを必要とせず、材料を効率よく使用できる。

CTP：Computer to Plateの略。印刷するデータをコンピューターから直接プレートに出力し、印刷版を作成する方法。

POD：Print on Demandの略。必要なときに必要な部数を印刷すること。

直接描画装置：回路パターンを高速・高精細に直接描画(露光)する装置。従来の露光方式に比べ、納期の短縮やコストの大幅な削減が可能。

2012年11月に開催された、機関投資家・アナリストさま対象の2013年3月期第2四半期決算説明会における質疑応答を掲載します。

Q 当上半期の業績が、8月7日(第1四半期決算発表時)に発表した業績予想よりも下回った理由は？

A 売上面では、主にメディアアンドプレジジョンテクノロジー事業におきまして、POD装置とプリント基板関連機器が予想を下回ったことによるものです。利益面では、主に半導体機器事業におきまして、受注額の減少に伴い工場操業度が低下したことや、コーターデベロッパ事業の収益が低下したこと、また回路微細化などに伴うお客さまからの要求条件の高まりにより装置搬入費用が想定以上に増加したことなどから、営業損失が予想より拡大したためです。さらに、単独の繰延税金資産の一部取り崩しによる法人税等調整額を計上したことにより、四半期純損失が予想より拡大する結果となりました。

Q 半導体機器事業の第2四半期(7-9月)の業績が、第1四半期(4-6月)と比較して、売上額の減少(9億円)に比べ営業損失が拡大(14億円)した理由は？

A プロダクトミックス(製品構成)の改善により限界利益は増加しましたが、次世代に向けたお客さまとの共同開発に伴うたな卸資産引当金が増加したことなどによるものです。

Q 今回、下半期の業績予想を修正した理由は？

A 主に半導体機器事業におきまして、第2四半期の受注状況や大手お客さまの設備投資抑制の動きを受け、売上予想を見直したためです。また、利益面でも、半導体機器事業におきまして、売上額の減少に伴う減益に加え、工場操業度の低下などを織り込み、下方修正を行いました。

Q 今後の収益改善に向けた取り組み内容は？

A 短期的には、上半期より進めております緊急対応策を強化し、変動費や一般経費など固定費の削減に取り組み、第4四半期(1-3月)での黒字転換を目指します。また、来期以降に向けて損益分岐点をさらに引き下げするため、収益構造改善の早期実行を図ってまいります。

用語解説

限界利益：売上高から変動費を差し引いた金額のこと。

変動費：生産量や販売数量の増減に応じて変動する費用のこと。例として、原材料費や荷造運賃費、外注費などが挙げられる。

固定費：生産量や販売数量の変化に関係なく、一定期間に一定額発生する費用のこと。例として、人件費、減価償却費、研究費などが挙げられる。

損益分岐点：売上高と総費用(変動費と固定費の合計)が等しく、利益も損失も出ない地点の売上高のこと。

(要約)連結財務諸表

連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	第2四半期累計期間		通期
	2013年3月期 2012年4月1日から 2012年9月30日まで	2012年3月期 2011年4月1日から 2011年9月30日まで	2012年3月期 2011年4月1日から 2012年3月31日まで
① 売上高	95,853	123,021	250,089
売上原価	75,812	90,143	187,324
売上総利益	20,041	32,877	62,765
販売費及び一般管理費	23,573	23,877	49,266
② 営業利益(△損失)	△3,531	9,000	13,498
営業外収益	566	1,001	1,589
営業外費用	732	1,185	2,802
経常利益(△損失)	△3,697	8,815	12,284
特別利益	0	0	38
③ 特別損失	1,120	1,236	5,045
税金等調整前四半期(当期) 純利益(△損失)	△4,818	7,578	7,277
法人税等	4,314	1,065	—
法人税、住民税及び事業税	—	—	2,041
法人税等調整額	—	—	541
法人税等合計	4,314	1,065	2,582
少数株主損益調整前四半期 (当期)純利益(△損失)	△9,132	6,513	4,695
少数株主利益(△損失)	27	△17	57
④ 四半期(当期)純利益(△損失)	△9,160	6,531	4,637

連結包括利益計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	第2四半期累計期間		通期
	2013年3月期 2012年4月1日から 2012年9月30日まで	2012年3月期 2011年4月1日から 2011年9月30日まで	2012年3月期 2011年4月1日から 2012年3月31日まで
少数株主損益調整前四半期 (当期)純利益(△損失)	△9,132	6,513	4,695
その他の包括利益	△2,928	△3,090	△503
包括利益	△12,061	3,423	4,191
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	△12,090	3,434	4,141
少数株主に係る包括利益	29	△10	50

ポイント

① 売上高

半導体機器事業およびFPD機器事業の売上が大幅に減少したことにより、売上高は958億円と前年同期に比べ271億円減少しました。

② 営業損失

売上の大幅な減少により、営業損失35億円を計上しました。

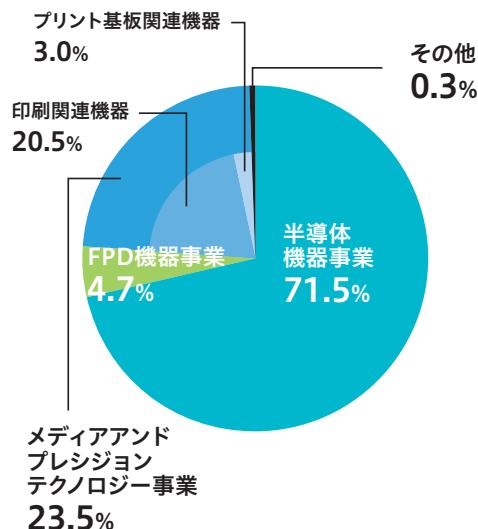
③ 特別損失

保有株式の時価下落に伴い、投資有価証券評価損11億円を計上しました。

④ 四半期純損失

特別損失の計上に加え、繰延税金資産の一部を取り崩したことから、四半期純損失は91億円となりました。

●事業セグメント別売上高構成比 (2013年3月期 第2四半期累計期間)



連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科目	第2四半期末		期末
	2013年3月期		2012年3月期
	2012年9月30日現在		2012年3月31日現在
(資産の部)			
5 流動資産	146,730		177,543
固定資産	65,750		67,838
有形固定資産	39,671		38,669
無形固定資産	2,397		2,145
投資その他の資産	23,681		27,024
資産合計	212,481		245,381
(負債の部)			
流動負債	105,841		123,223
固定負債	29,298		31,562
6 負債合計	135,140		154,786
(純資産の部)			
株主資本	91,477		101,827
その他の包括利益累計額	△14,689		△11,758
少数株主持分	552		527
7 純資産合計	77,340		90,595
負債純資産合計	212,481		245,381

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円未満切捨)

科目	第2四半期累計期間		通期
	2013年3月期	2012年3月期	2012年3月期
	2012年4月1日から 2012年9月30日まで	2011年4月1日から 2011年9月30日まで	2011年4月1日から 2012年3月31日まで
8 営業活動による キャッシュ・フロー	△1,081	2,820	11,278
9 投資活動による キャッシュ・フロー	△2,891	△755	△4,162
10 財務活動による キャッシュ・フロー	△2,974	12,693	△9,467
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	27,811	51,713	35,631

※詳細な財務諸表に関しましては、下記のウェブサイトより、平成25年3月期第2四半期決算短信をご覧ください。

URL: <http://www.screen.co.jp/ir/library/2013.html>

ポイント

5 流動資産

現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したことなどにより、前期末に比べ308億円減少しました。

6 負債合計

支払手形及び買掛金の減少などにより、負債合計は前期末に比べて196億円減少し、1,351億円となりました。このうち、有利子負債は17億円減少し459億円となりました。また、有利子負債から現金及び預金を除いた純有利子負債は、61億円増加し161億円となりました。

7 純資産合計

配当金の支払いや四半期純損失の計上による利益剰余金の減少などにより、前期末に比べ132億円減少し、773億円となりました。以上の結果、当第2四半期末の自己資本比率は、36.1%となりました。

ポイント

8 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失の計上、たな卸資産の増加、仕入債務の減少などの支出項目が、減価償却費、売上債権の減少などの収入項目を上回り、10億円の支出となりました。

9 投資活動によるキャッシュ・フロー

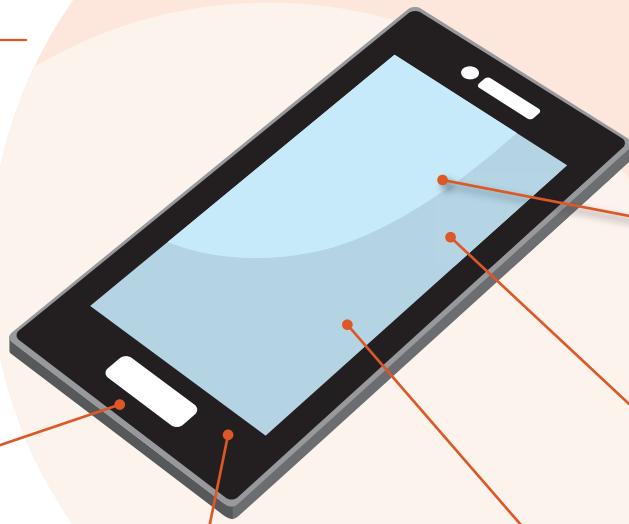
研究開発設備等の有形固定資産を取得したことなどにより、28億円の支出となりました。

10 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金やリース債務の返済、配当金の支払いなどにより、29億円の支出となりました。

クローズアップ—スマートフォンと当社製品—

急速に普及しているスマートフォン（高性能携帯電話）。画面が大きく、インターネットの閲覧や電子メールの送受信ができ、さらには好みのアプリケーションソフトをインターネットから入手して機能を追加できるなどの特徴があります。今回は、このスマートフォンと当社製品の関わりについてご紹介します。



○ 半導体

パソコンとほぼ同様の機能を持つスマートフォンには、数多くの半導体が搭載されています。

● ウエハー洗浄装置

半導体をつくる工程で、ウエハーに付着した微小なパーティクル（金属や有機物などの微粒子）や汚れを除去する装置



枚葉式洗浄装置「SU-3200」

スマートフォンなどの電子機器の小型高性能化や低消費電力化に伴い、半導体の基板となるウエハー上に形成する回路線幅の微細化が進んでいます。微細化に伴って、パーティクルの許容サイズが小さくなり、より徹底した洗浄が必要になる一方で、回路パターンが壊れやすくなるなど困難さが増しますが、当社は10ナノメートル*1台の超微細回路にもダメージを与えず精密な洗浄が行える技術を開発しており、世界最高水準の枚葉式洗浄装置を提供しています。

○ プリント基板

半導体などの電子部品間を配線して電子回路を形成するプリント基板は、スマートフォンに不可欠なパーツです。

● 外観検査装置

プリント基板の回路パターンを検査する装置



プリント基板用外観検査装置「PI-9500」

高機能化が進むにつれ、限られたスペースに多数の電子部品を搭載するために、基板の高精細化・高密度化が進んでいます。当社は超高精細な基板を高速かつ精密に検査できる装置をお客さまに納めています。

● 直接描画装置

プリント基板の回路パターンを直接描画（露光）する装置



プリント基板用直接描画装置「Ledia 5」

スマートフォンの急速な普及を受けて、基板に精密な回路パターンを高速かつ正確に露光できる直接描画装置の需要が高まっています。当社は業界最高水準の生産性を実現した装置を開発し、拡販を進めています。

○ スマートフォンの部品

● 当社製品

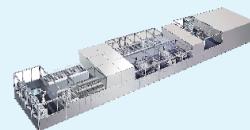
○ ディスプレー

主に液晶ディスプレイが使われていますが、液晶に比べて高輝度・薄型・軽量・低消費電力などの利点を持つ有機ELディスプレイの採用も増加しています。

● 液晶用コーターデベロッパ

液晶パネルのベースとなるガラス基板に、フォトレジスト(感光材)の塗布や現像処理を行う装置

液晶パネルメーカーの投資がテレビ向けの大型パネルからスマートフォンやタブレット型端末向けの中小型パネルへシフトしています。当社では、中小型パネル向けの低温ポリシリコンTFT液晶^{*2}に対応した装置をそろえ、お客さまのニーズに応じています。また、当社のコーターデベロッパは、有機ELパネルの製造工程でも使われています。



液晶用コーターデベロッパ
「SK-N1300G」

○ タッチパネル

スマートフォンの多くには、指やペンで画面に直接触れることにより機器を直感的に操作できるタッチパネルが装着されています。

● 透明電極測定検査技術

タッチパネルの構成部品である透明電極^{*3}の回路の線幅や膜圧を測定・検査する技術

長年蓄積した光学技術や画像技術に加え、プリント基板検査装置で培った検査技術を応用し、タッチパネルの透明電極のパターンを光学的に可視化し、高精度に測定・検査する技術を開発。現在、この技術を搭載した測定検査装置の商品化を進めています。

● ヒラギノフォント

日本語の読みやすさと美しさを追求した当社のヒラギノフォントは、アップル社のスマートフォン「iPhone」に標準搭載されています。また、iPhone用の日本語辞書アプリケーションである株式会社 物書堂の「大辞林」にも採用されています。

そのほか、製品のカタログや包装(パッケージ)、取り扱い説明書などの印刷に、当社の印刷関連装置が使われています。

用語解説

- *1 ナノメートル:** 1ナノメートルは10億分の1メートル。
- *2 低温ポリシリコンTFT液晶:** 低温で多結晶化されたシリコンをTFT(薄膜トランジスター)の素材に用いた液晶パネル。高輝度・高精細・低消費電力などの特徴を持つことから、小型携帯端末のディスプレイに適している。
- *3 透明電極:** 液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイやタッチパネルなど、光透過性と通電性を両立するデバイスに不可欠の電子材料。ガラスなどの透明な基板に透明導電膜を成膜して製造する。

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会 3月31日 剰余金の配当 3月31日 (当社は中間配当制度を採用しておりません。)
単元株式数	1,000株
公告方法	電子公告により、当社ホームページ (http://www.screen.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所	大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	電話 0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および 全国各支店で行っております。

1. 「特別口座」に記録された株式をお持ちの株主さま

株券電子化までに証券保管振替機構(ほふり)に株券を預託されなかった株主さまの株式は、当社が三井住友信託銀行に開設しました「特別口座」に記録されています。特別口座では、株式の売買が制限されておりご不便かと存じますので、証券会社に開設されました一般口座へ振替されることをお勧めいたします。お手続きの詳細は上記の三井住友信託銀行にお問い合わせください。

2. 単元未満株式をお持ちの株主さま

当社に対して、次の請求を行うことができます。

【買増請求】 単元株式(1,000株)に不足する株式の買増し

【買取請求】 単元未満株式の買取

お手続きの詳細は、お取引の証券会社(特別口座が開設されました株主さまは、三井住友信託銀行)にお問い合わせください。

株価および出来高の推移



ホームページのご案内

当社ホームページの「IR情報」では、決算発表資料やニュースリリースなど、さまざまな情報をご覧いただけます。また、当社の最新ニュースをメールでお知らせする「IR配信メールサービス」も実施しております。ぜひご利用ください。

「IR情報」トップページ

<http://www.screen.co.jp/ir/>

メール配信サービスのご登録はこちら

<http://www.screen.co.jp/ir/mail/>



大日本スクリーン製造株式会社

〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 電話075(414)7111

ホームページアドレス: <http://www.screen.co.jp/> 証券コード7735

SCREEN NOW Vol.85 発行日: 2012年12月13日(発行は3月、6月、9月、12月) 発行: IR室

「SCREEN NOW」(株主通信)は、当社のフォント「ヒラギノ書体」を使用しております。

UD FONT
by HIRAGINO

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

